

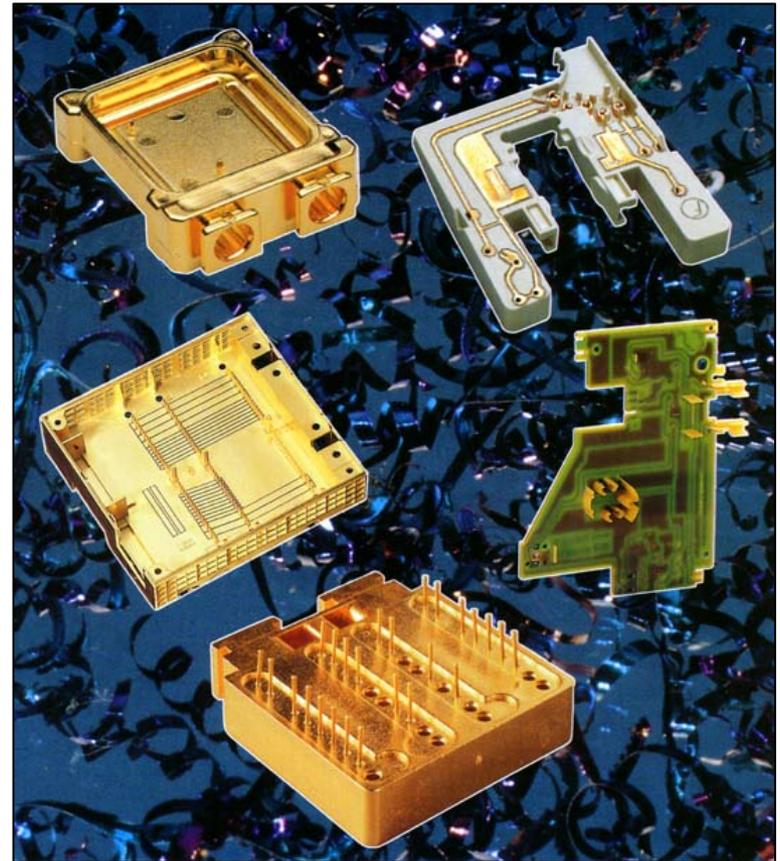
3D MID-Technologie

Aufbau- und Verbindungstechnik zwischen Mikroelektronik und Mikrosystem

MID = Moulded Interconnect Device
(Spritzgegossener Schaltungsträger)

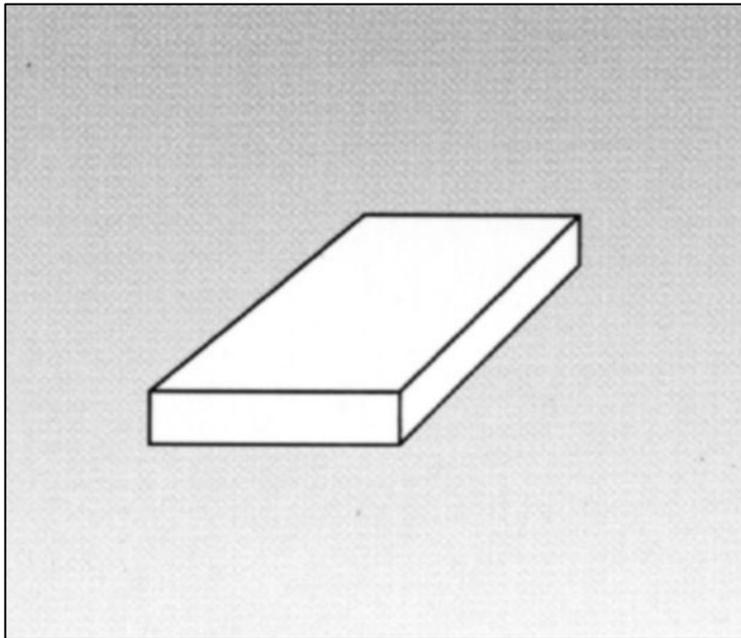
3D MID-Technologie

- Volumenreduzierung
- Verringerung des Montageaufwandes
- Reduzierung der Teilezahl
- Hohe Dauertemperaturbelastung möglich
- Die eingesetzten Kunststoffe sind umweltunbedenklich
- Mechanische Halte- und Stützfunktion
- Abschirmung und Kühlung

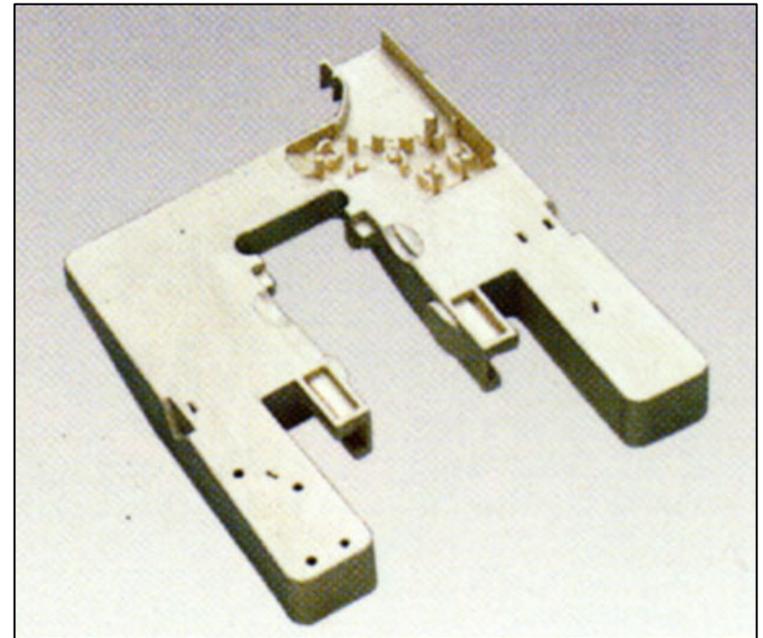


Quelle: Werbeblatt von FUBA

3D MID-Technologie

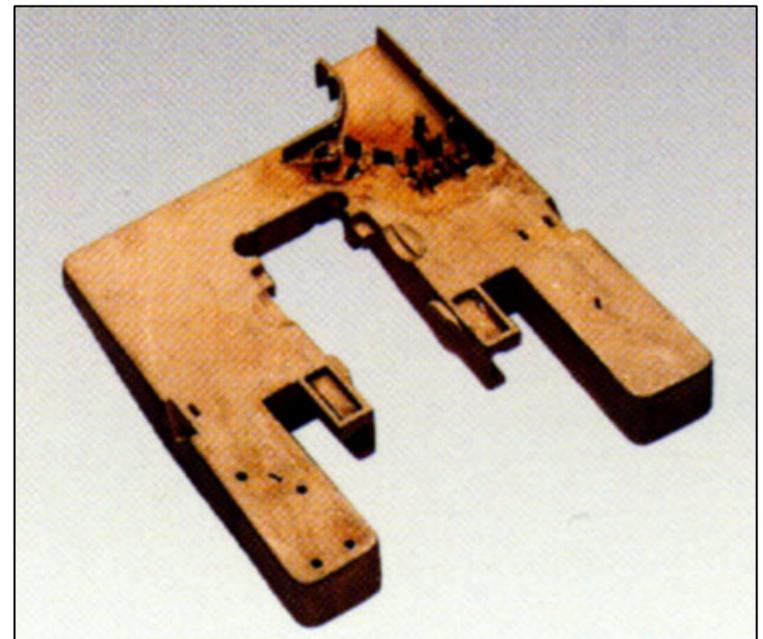
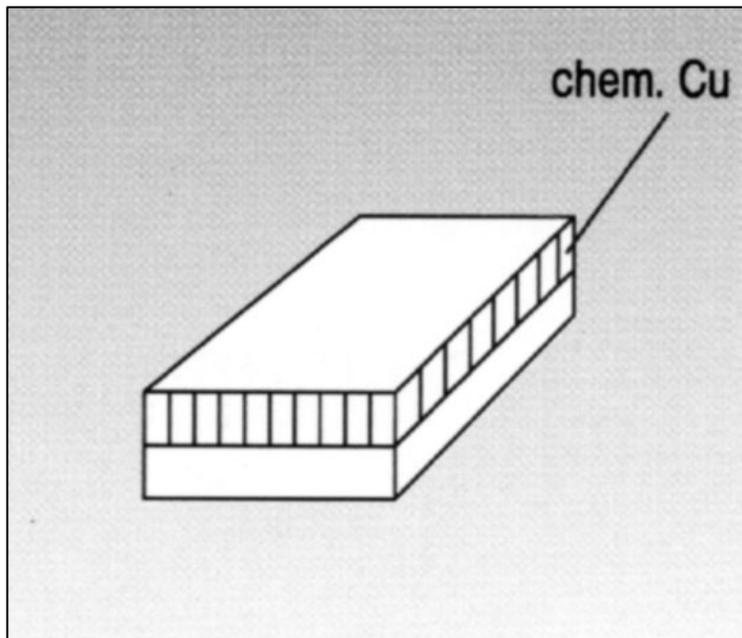


Kunststoffspritzling



Quelle: Werbeblatt von FUBA

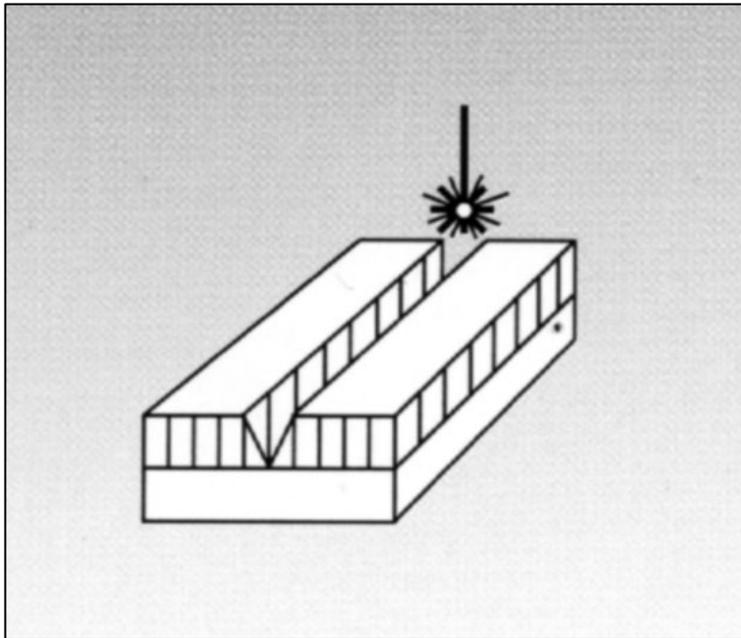
3D MID-Technologie



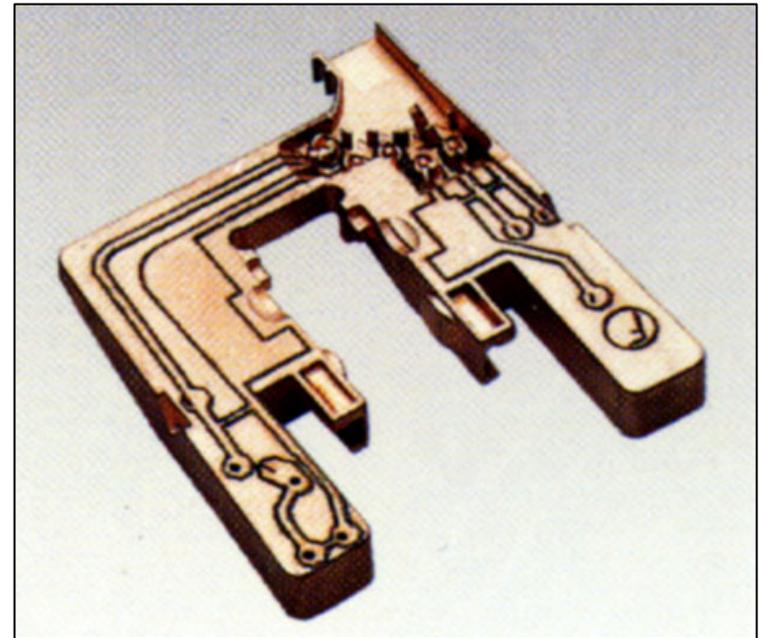
Quelle: Werbeblatt von FUBA

Beschichtung mit chemischen Kupfer

3D MID-Technologie

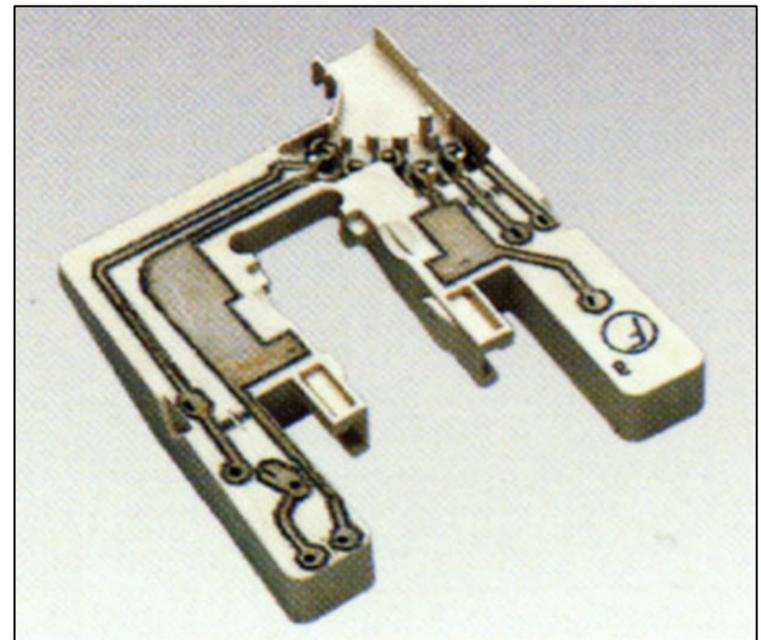
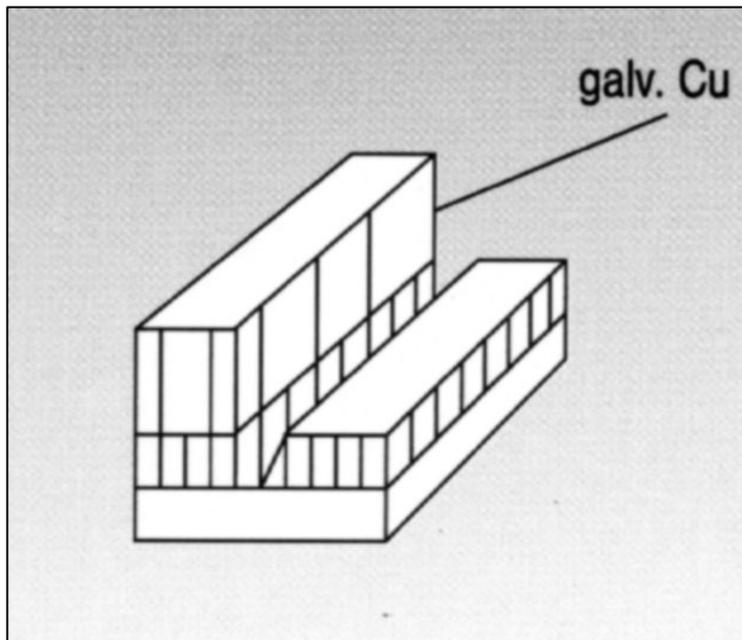


Laserstrukturierung



Quelle: Werbeblatt von FUBA

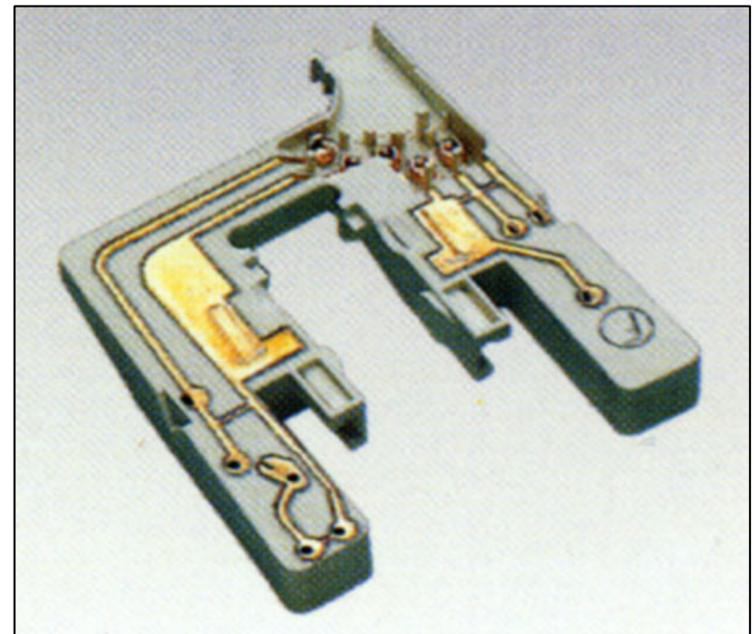
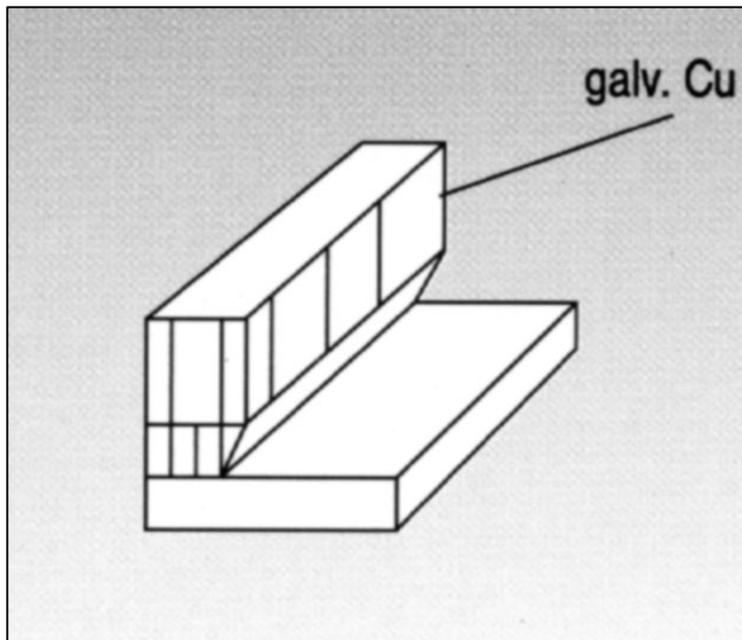
3D MID-Technologie



Quelle: Werbeblatt von FUBA

Selektive Nachverstärkung mit galvanischen Kupfer

3D MID-Technologie



Quelle: Werbeblatt von FUBA

Differenzätzen und Oberflächenfinish